

事業説明会 機能製品事業

機能製品統括部門長

大野 良次

2020年11月17日/24日

古河電気工業株式会社

将来情報についての注意事項

この資料に記載されております売上高及び利益等の計画のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、当社グループの各事業に関する業界の動向についての見通しを含む経済状況、ならびに為替レートの変動その他の業績に影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報をもとにした当社グループの仮定及び判断に基づく見通しを前提としております。

これら将来予想に関する記述は、既知または未知のリスク及び不確実性が内在しており、例として以下のものが挙げられますが、これらに限られるものではありません。

- ・米国、欧州、日本その他のアジア諸国の経済情勢、特に個人消費及び企業による設備投資の動向
- ・米ドル、ユーロ、アジア諸国の各通貨の為替相場の変動
- ・急速な技術革新と当社グループの対応能力
- ・財務的、経営的、環境的な諸前提の変動
- ・諸外国による現在及び将来の貿易規制等
- ・当社グループが所有する有価証券等の時価の変動

従いまして、実際の売上高及び利益等と、この資料に記載されております計画とは大きく異なる場合があることをご承知おき下さい。なお、当社グループは、この資料の本リリース後においても、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものではありません。

著作権等について

この資料のいかなる部分についてもその著作権その他一切の権利は、古河電気工業株式会社に帰属しており、あらゆる方法を問わず、無断で複製または転用することを禁止します。

古河電気工業株式会社

- 1. 中期計画基本方針と強み**
- 2. 20年度実績・通期予想**
- 3. 今後の戦略**

1. 中期計画基本方針と強み

Furukawa G Plan 2020 基本方針

お客様との共創を図り、常にソリューションを提供

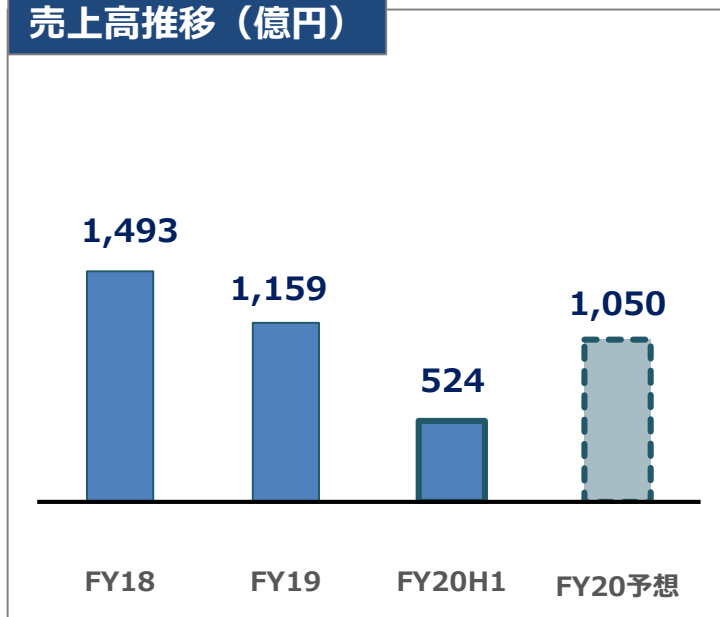
顧客ニーズに沿った新製品の提案力・開発力を強みに5Gとサステイナブル社会を支えます



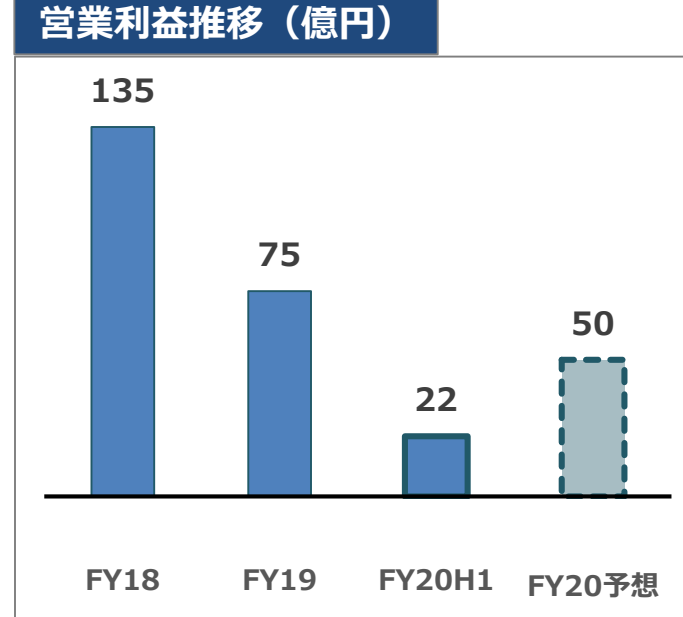
2. 20年度実績・通期予想

- データセンタ市場の回復により、サーマル製品/メモリーディスク事業の収益は改善
- 機能樹脂製品は、新型コロナウイルスによる国内民間建築工事の遅れや、海外自動車関連需要落ち込みにより厳しい状況が継続
- 半導体製造用テープは、スマートフォン向け需要低迷や顧客在庫調整影響により収益悪化見通し
- 銅箔事業は、自動車需要減少や、昨年度の台湾製造拠点火災による回路用箔生産能力低下が主な収益悪化要因

売上高推移（億円）



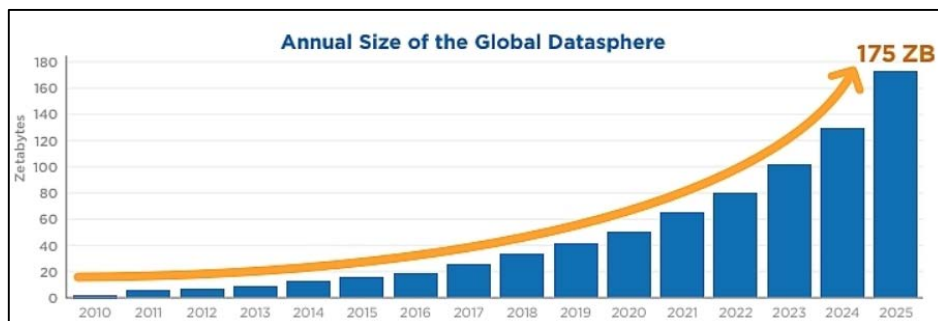
営業利益推移（億円）



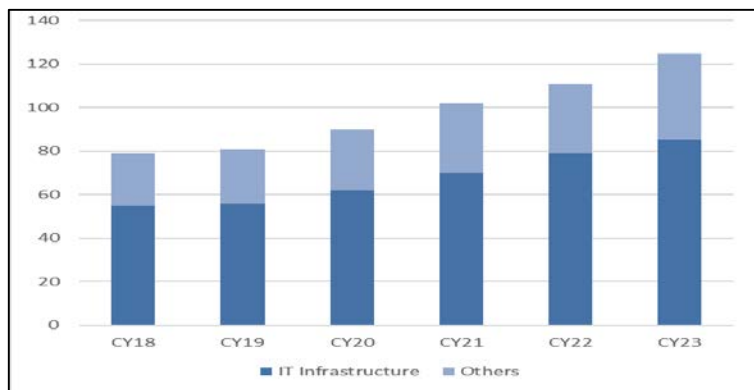
3. 今後の戦略（1）

5G、データセンタ関連事業＝データ需要拡大に応える「次世代品の開発」に注力

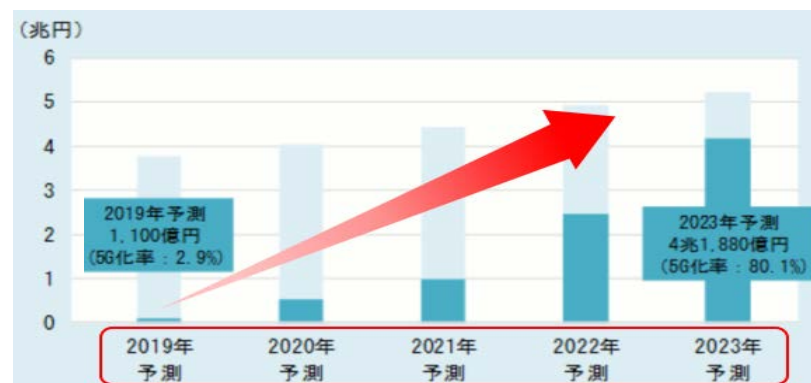
全世界で生成されるデータは指数関数的に上昇



データセンターへの投資は今後も成長



5G環境整備のため基地局市場が成長



- <サーマル・電子部品> データ増に伴う熱問題を解決
- <メモリーディスク> HDD大容量化を実現する基板薄型化
- <銅箔> 高機能回路基板用銅箔の開発

3. 今後の戦略（2）

<AT製品>

- 半導体の性能変更に伴う加工プロセスの進化に継続的に対応
（半導体チップの薄膜化への対応、カメラモジュールの高速応答性への対応）
- 新規市場開拓および新用途の提案

<機能樹脂製品>

- コロナ禍でも有効な工事対応不足に対する「スキルフリー製品」の拡販を強化
- 架橋ポリエチレンフォームを使用した避難時用マットを開発、自治体と共に防災・減災への取り組みを推進

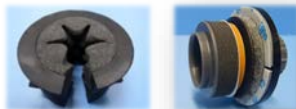
スキルフリー製品



角型エフレックス



グリーントラフ
傾斜地対応トラフ橋



壁貫通部の
防火・防水製品

防災製品



避難時用マット

ご清聴ありがとうございました。

Bound to  ***Innovate***

Appendix 製品紹介

	AT・機能樹脂		サーマル・電子部品	メモリーディスク	銅箔	
						
主な製品	<ul style="list-style-type: none"> ・半導体製造用テープ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ケーブル保護管 ・リサイクルトラフ ・断熱材 	<ul style="list-style-type: none"> ・銅等のヒートシンク、ヒートパイプ 	<ul style="list-style-type: none"> ・HDD用アルミblank材 	<ul style="list-style-type: none"> ・回路基板用電解銅箔 	<ul style="list-style-type: none"> ・電池用電解銅箔
主な用途	<ul style="list-style-type: none"> ・半導体ウエハの加工工程での、表面保護や固定など ・フラッシュメモリー内の半導体チップ積層 	<ul style="list-style-type: none"> ・地中埋設ケーブルの保護管 ・ケーブル格納用トラフ ・空調配管用断熱材 	<ul style="list-style-type: none"> ・CPUやパワー半導体、電子部品、高出力LED照明などの放熱・冷却 	<ul style="list-style-type: none"> ・データセンタやデスクトップPC、監視カメラ用途などのHDD 	<ul style="list-style-type: none"> ・通信機器、電子機器の回路基板 	<ul style="list-style-type: none"> ・電気自動車、スマートフォン、電動工具などに用いるリチウムイオン電池の負極材
主な顧客	<ul style="list-style-type: none"> ・半導体メーカー ・ファウンドリメーカー 	<ul style="list-style-type: none"> ・ゼネコン・サブコン ・鉄道会社 ・道路公団・道路サブコン ・空調配管メーカー 	<ul style="list-style-type: none"> ・データセンタ、通信基地局事業者 ・スマートフォン・PCメーカー ・鉄道・太陽光発電用パワコンメーカー ・照明機器メーカー 	<ul style="list-style-type: none"> ・HDDサブ基板メーカー 	<ul style="list-style-type: none"> ・回路基板材料メーカー ・リチウムイオン電池メーカー 	

<正の影響の強化>

放熱・冷却機構の高性能化されたサーマル製品により、同製品主用途の一つであり、電力消費量の面でも世界的に注目されているデータセンターの消費エネルギー効率化、ランニングコスト低減等を実現し、情報通信の高速大容量化に貢献します。



<負の影響の最小化>

製造工程におけるエネルギー使用に関しては、製造子会社での省エネ・再生可能エネルギー利用比率の向上を推進しています。

